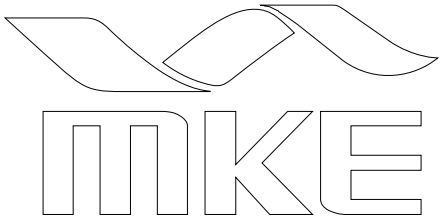
시스템반도체 업계 간담회

2011년도
시스템반도체산업 육성 대책



2011. 1

지 식 경 제 부

목 차

Ⅰ. 반도체 산업동향 및 전망 ····· 1

Ⅱ. 우리나라의 반도체산업의 구조적 문제점 ····· 3

Ⅲ. 그동안의 정부지원 평가 ····· 6

Ⅳ. 중점 추진과제 ····· 7

1. 핵심기술의 전략적 개발 ····· 7

2. 연구인력 등 기술 인프라 보강 ····· 8

3. 선순환적 생태계 조성 노력 강화 ····· 9

4. SW-시스템반도체 동반육성 전략 수립 ····· 11

Ⅰ. 반도체 산업동향 및 전망

□ **(세계 반도체산업)** '10년 세계반도체 시장은 전년대비 32.8% 증가한 3,040억불이었으나, **'11년에는 5.4% 증가한 3,205억불 예상**

○ 메모리반도체 시장은 반도체 단가하락과 기저효과 등으로 **전년대비 △3.4%감소한 664억불로 예상**

○ **시스템반도체 시장은** 스마트폰·태블릿PC 등의 시스템시장의 수요증가에 따라 **전년대비 8%증가한 2,514억불 예상**

< 반도체 시장 추이 (단위 : 억불, iSuppli) >

구 분	2009	2010					2011(F)				
		1Q	2Q	3Q	4QE	소계	1Q	2Q	3Q	4Q	소계
반도체	2,289.0	703.1	754.4	797.9	784.7	3,040.1	742.9	765.9	813.1	816.5	3,138.4
증가율	△11.9%	2.0%	7.3%	5.8%	△1.7%	32.8%	△5.3%	3.1%	6.2%	0.4%	3.2%
메모리반도체	441.0	159.2	176.3	181.6	170.3	687.4	160.0	159.7	169.6	174.8	664.1
증가율	△3.6%	5.0%	10.7%	3.0%	△6.2%	55.7%	△6.0%	△0.2%	6.2%	3.0%	△3.4%
시스템반도체	1,848.0	543.8	578.1	616.3	614.4	2,352.6	582.8	606.1	642.5	644.7	2,476.1
증가율	△13.6%	1.0%	6.3%	6.6%	△0.3%	27.3%	△5.1%	4.0%	6.0%	0.3%	5.2%

□ **(반도체 가격)** '10년 대비 D램 단가 △44%, 낸드 단가 △33% 감소 전망

○ **(D램)** '10.4Q의 급속한 단가 하락 및 삼성전자 16라인의 낸드 플래시 집중 등으로 **1.4~1.5불**(1Gb환산)선에서 안정

○ **(낸드)** 스마트폰·태블릿 등의 수요는 급증하나, '10년 평년 수준의 2배가 넘는 설비투자 등으로 **1.2~1.4불**(8Gb환산)대에서 가격 형성 전망

< 메모리 가격동향 (단위 : D램 1Gb / 낸드 8Gb환산, 달러) >

구 분	2009				2010				2011				2012			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
D램	1.6	1.9	2.2	2.7	2.8	3.0	2.7	1.9	1.5	1.5	1.4	1.4	1.2	1.1	1.0	0.9
낸드	1.8	2.2	2.3	2.2	2.1	2.0	1.8	1.6	1.4	1.2	1.2	1.2	1.0	0.8	0.7	0.7

* 출처 : 한국반도체산업협회

□ **(국내 반도체산업)** 침체기의 공격적 설비·R&D 투자가 매출로 연결되며 **우리나라의 시장점유율이 지속적으로 확대('09년 11.3%→'10년 13.2%)**

* 반도체 점유율 : (09.4Q)12.1% → (10.1Q)12.5% → (2Q)13.6% → (3Q)13.8% → (4Q)13.0%

○ 우리기업은 시스템반도체에 대한 투자를 지속 확대중이며, **'11년 투자액은 48.6% 확대된 30억불에 달하는 등 파운드리 투자 본격화**

* 전체투자중 시스템반도체 투자비중 : ('09)8% → (10)17% → ('11)32%

< 시스템반도체 설비투자 추이 (단위 : 백만불, USB) >

구 분	2009	2010					2011(F)				
		1Q	2Q	3Q	4QE	소계	1Q	2Q	3Q	4Q	소계
시스템반도체	400	218	322	520	1,017	2,075	1,065	1,070	965	965	4,085
한국 전체	4,779	3,720	2,500	2,618	3,194	11,932	3,285	3,180	3,227	2,790	12,472

□ **(수출)** 시스템반도체(파운드리) 투자확대와 지속적인 역량강화로 **'11년 수출은 시스템반도체가 주도하기 시작할 것으로 전망**

○ **(메모리)** 단가 하락, 전년대비 수요 요인 감소(PC 등) 및 상반기 재고 물량 등의 영향으로 **'10년 대비 △9.3% 감소한 258억불** 예상

○ **(시스템반도체) 시장 비중확대,** 파운드리 투자 확대 및 조립물량 증가 등으로, **'10년 대비 18.7% 증가한 191억불 예상**

< 연도별 수출 실적 및 전망 (단위 : 백만불, 전년대비 %) >

구 분	2007	2008	2009	2010	2011E
반도체 전체	39,045	32,801	31,042	50,707	52,456
증가율	4.5%	△16.0%	△5.4%	63.3%	3.5%
메모리	22,392	17,030	15,865	28,470	25,814
증가율	30.8%	△23.9%	△6.8%	79.5%	△9.3%
시스템반도체	14,183	13,127	12,292	16,093	19,104
증가율	△21.8%	△7.4%	△6.4%	30.9%	18.7%
광개별소자	2,470	2,644	2,885	6,144	7,438
증가율	16.9%	7.0%	9.1%	113.0%	21.1%

Ⅱ. 우리나라의 반도체산업의 구조적 문제점

◇ **아직도 메모리 위주의 산업구조가 문제**

○ 세계시장 **점유율이 50%를 초과한 메모리 반도체는 더 이상 시장 점유 확대가 쉽지 않고, 메모리 집적기술도 거의 한계에 도달**

* 반도체 세계시장점유율(%) : ('00)7.4 → ('05)10.2 → ('10^{e})13.2 (세계3위)
* 메모리 시장점유율(%) : ('00)27.0 → ('05)42.5 → ('10^{e})50.1 (세계1위)

○ 메모리칩 미세화에 따라 장비 의존과 자동화 경향이 높아져서 **메모리부문 투자와 수출확대로만 고용을 늘리는 것은 한계에 직면**

* 취업유발계수(명/10억, 한은) : (반도체)4.5, (자동차)9.9, (일반기계)11.2, (섬유)15.5

○ 막대한 **투자자금이 필요하고 경기변동에 민감**하여 **수익구조 변동폭이 확대**되는 메모리 산업의 구조적 특성도 문제

* 메모리반도체 1개 생산라인(300mm 웨이퍼 기준) 건설비는 약 3~5조원

◇ **시스템반도체와 장비의 해외의존도가 크게 개선되지 않고 있는 것도 문제**

○ 최근 수출호조에도 불구하고 시스템반도체의 **세계시장 점유율('10년 기준)은 3%에 불과**하며, **수입액은 186억불**에 달함

* '10년 수출입(억불) : (시스템반도체)수출161, 수입186 // (메모리)수출285, 수입60

○ **반도체장비·재료 수입규모는 '10년 98억불**로, 국내 기업의 설비투자시 **설비의 63%를 일본 등으로부터 수입**해야 하는 상황

* '10년 반도체설비투자는 12조원이나 장비수입은 9.3조원

□ **(인력측면)** 국내 인력양성 기반 취약 등으로 **선진국에 비해 설계 인력이 부족**하고 특히, **중소기업의 우수 인력확보가 어려움**

* 설계인력 규모('09) : 美퀄컴(12,800명), 臺미디어텍(4,100명), 韓엠텍비젼(216명)

○ '15년까지 국내 업계는 연 4천명의 인력을 고용할 계획이나, 국내 공급 능력은 연 2천명에 불과하여 **연간 2천여명의 인력 부족 예상**

* 부족인력의 60%는 석·박사급 인력(연1,200명)으로 고급인력 확보에 특히 애로
* 대학 정규 과정에서는 설계 제작 프로그램을 제공하지 않고 있으며, 반도체칩 제작경험이 있으며 아키텍트급 인력을 양성할 수 있는 **국내 교수인력은 30여명으로 매우 부족**
* 대만은 Si-Soft 프로그램을 활용한 **설계분야 교수채용 지원, 높은 성과급 및 병역 특례제도 등 우수한 보상체계**를 통해 지난 20여년간 **실리콘밸리 유 경험 과학기술자 12만명이 대만으로 귀국**했으며, 이는 세계 2위의 팹리스 강국으로 도약하는 기반이 됨

□ **(기술측면) Display구동칩[1], Image센서[2]** 등 메모리와 구조가 유사한 일부 범용성 품목은 **세계적 경쟁력**을 **확보**했으나,

1) DDI(Display Driver IC, 세계3위 / 21.5%) : DTV, 모니터, 네비게이션 등 구동장치
2) CIS(CMOS Image Sensor, 세계4위 / 12%) : 디지털카메라, 휴대폰 등의 촬영센서

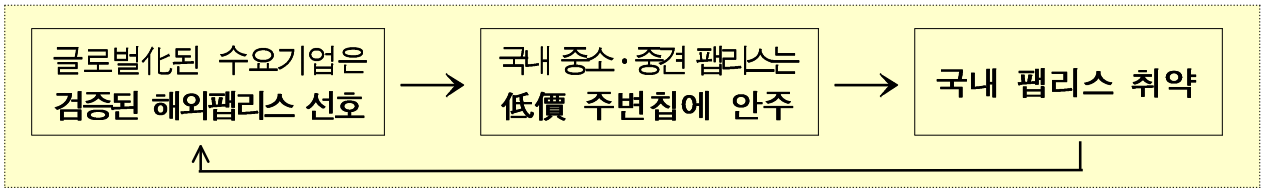
○ **핵심칩인 프로세서, 모뎀칩은 전량 수입에 의존**하고 있으며 스마트폰 등 **융복합 제품의 핵심 칩셋에 대한 기술경쟁력 취약**

* 수입규모('09) : 휴대폰 모뎀칩 34억불, 모바일 프로세서 8.6억불, PC CPU 7억불
* R&D투자규모('09) : (국내 팹리스기업) 평균 43.5억원, (美퀄컴社) 24.4억불

□ **(산업생태계 측면)** 우리의 반도체산업이 대기업·IDM위주로 **메모리 산업에 집중**되면서, 현대자동차, LG전자 등 글로벌 수요업체가 있음에도 불구하고 **Fabless-Foundry-수요기업간 유기적인 협력이 취약**

○ **(팹리스-수요기업)** 수요기업은 글로벌 sourcing으로 인하여 국내 중소·중견 팹리스 기업과의 **공동 제품기획 및 R&D에 소극적**

< 국내 팹리스 성장의 악순환 >



○ **(팹리스-파운드리) 파운드리 시설, 설계자산(IP) 및 지원 공정의 다양성 부족** 등으로, 팹리스 기업이 대만 등 해외의 파운드리에 의존하여 **국내 파운드리의 경쟁력 약화 및 cost 상승요인**으로 작용

* 국내 팹리스의 파운드리 선호순위('10.3 반도체협회) : **臺TSMC(18%)** > 삼성전자(16%) > **臺UMC(13%)** > 매그나칩(12%) > **中SMIC(11%)** > 동부하이텍(8%)

* 대만의 TSMC는 빠른 설비투자, 높은 가격경쟁력, 다양한 IP 보유 등을 토대로 전세계 고객의 다양한 수요를 충족시키고 있으며 이를 규모의 경제효과로 연결

○ **(클러스터) 반도체 클러스터가 형성되지 않아 기업간 네트워킹, 기술정보 공유 미흡** 등으로 **전체 산업의 혁신역량 낭비**

* 선도국은 실리콘밸리(美), 과학공업단지(臺) 등 반도체 클러스터 중심으로 발전하고 있으나, 우리는 Fabless기업, 시스템반도체산업진흥센터 등이 산재

□ **(기업역량 측면)** 인력, R&D 및 생태계의 취약성 등의 영향으로 인하여 **우리의 기업들은 글로벌 대기업에 비해 규모 및 경쟁력이 매우 미흡**

○ 종합반도체회사(IDM)의 경우 PC의 CPU를 생산하는 **美인텔이 세계 1위**이며, **삼성전자의 시스템반도체 매출실적은 인텔의 1/9수준**

* '10년 삼성전자의 반도체부문 예상 매출액은 281억불이며, 이중 시스템반도체 매출액은 43억불

○ Fabless는 휴대폰 모뎀칩 업체인 퀄컴 등 **美기업이 압도적**이며, **국내 120여개 팹리스의 '10년 전체 매출액은 15억불로 퀄컴의 1/5수준**

* 대만의 미디어텍은 '09년 22%의 성장률을 보이며 세계 3위의 팹리스 기업으로 성장하였으나, 우리나라 팹리스 1위 기업인 실리콘웍스는 51위에 불과

○ Foundry는 **TSMC**(세계 1위)등 **대만기업**이 주도하고 있으며, **동부하이텍 매출액은 TSMC의 1/25수준**

* **미국은 실리콘밸리, 세마텍** 등을 통한 **원천기술, 고급 설계인력이** 경쟁력 원천으로 생산은 대만 Foundry에 위탁하고 설계기술에 역량 집중

< 시스템반도체 매출 상위 기업 (백만불, '10) >

	IDM	매출		팹리스	매출		파운드리	매출
1	인텔(美)	39,025	1	퀄컴 (美)	7,200	1	TSMC (臺)	13,220
2	TI (美)	12,966	2	브로드컴 (美)	6,506	2	UMC (臺)	3,874
3	르네사스(日)	11,463	3	AMD (美)	6,355	3	Global Foundry (美)	2,098
13	**삼성전자(韓)**	**4,329**	**51**	**실리콘웍스(韓)**	**216**	**6**	**동부하이텍(韓)**	**530**

Ⅲ. 그동안의 정부지원 평가

□ 그동안의 정부지원은 **'97년까지는 메모리 중심으로, 이후에는 시스템반도체 중심으로 지원**

○ 메모리 반도체는 '81년 반도체 육성계획 수립이후 **4M~256M개발 지원** 등 주요 국책과제에 **국비 2,130억원 지원** (민간포함 총 5,312억원)

* 256M DRAM 개발과제시 정부 906억원, 민간 1,040억원 지원 등

○ 시스템반도체는 지난 10여년간 **시스템IC 2010사업 등 국비 약 6,500억원**을 지원하여 발전기반을 조성

- 그간의 정부지원은 주요 R&D에 집중되어 지원되었으며, 이를 통해 Display구동칩, Image센서 등 일부 품목의 경쟁력 확보 가능

□ 설비투자 중심의 메모리에 비해 **인력중심 시스템반도체의 경쟁력 제고에는 한계**

○ 메모리반도체는 **민관공동 R&D와 대기업의 과감한 투자**를 통해 '02년 이후 **세계 메모리 시장을 주도**

○ 시스템반도체는 창의적 인력양성이 중요하나, **그동안 가시적 성과 창출을 위한 기업중심 R&D지원으로 인하여** 창의적 설계인력 양성을 위한 시스템구축에는 미흡

☞ 우수한 인재가 산업생태계를 이끄는 **선진국형 선순환 구조구축은 요원한 상황**

◇ 창의적 설계인재 등 **시스템반도체 인재양성을 위한 근본대책 마련 긴요**

◇ 전량수입에 의존하고 있는 **핵심칩인 프로세서, 모뎀칩 등의 국산화와** 수요기업과의 수평적 파트너쉽 등 **선순환 산업생태계 구축도 필요**

Ⅳ. 중점 추진과제

1 핵심기술의 전략적 개발

◈ 휴대폰, DTV, 자동차 등 3대 핵심 분야에 대한 "**수요연계형 대형 R&BD 방식**"의 **기술개발 추진**
◈ **중소 Fabless 업체와 수요 대기업이 동반 추진**하는 방향으로 기획

1 휴대폰 분야

○ 「**미래산업선도기술개발사업**('11년 191억원, 13년까지 총 700억원)」에 의거 "4G용 베이스밴드 모뎀칩, AP(Application Processor), RFIC(고주파 칩)" 등 **핵심부품개발 추진**

- 경쟁기획*(R&D 전략기획단, 4월까지)을 거쳐 **5월중 사업자 선정·개발** 추진

* 현재 삼성전자 컨소시엄(알파언, 라온텍, 텔레칩스, ETRI, TTA 등), LG전자 컨소시엄(SK텔레콤, 동부하이텍, 지시티리서치, 엠텍버전, ETRI 등)이 경쟁기획 중
* 개발과제 국산화율 : 베이스밴드모뎀칩 0%, AP 27%, RFIC 12%

- 최근 발표한 「**차세대 모바일 주도권 확보 전략**」을 뒷받침

2 자동차·D-TV 분야

○ 「시스템반도체 상용화기술개발('11년 150억원, '15년까지 1,138억원)」에 의거 자동차용(브레이크 제어칩, 차간거리제어칩, 모터제어칩 등), D-TV용(신호변환칩, 화질개선칩, 튜너칩 등) **차세대 주력제품의 핵심 칩** 개발

- 2월 중 수요조사(산업기술평가관리원), 기획('11.5월)을 거쳐 7월까지 과제 및 사업자 선정·개발 추진

3 「전자정보디바이스원천기술개발사업」에 의거 휴대폰, 스마트가전, 자동차, 에너지, 바이오용 시스템반도체의 **원천기술개발(신규 39억원, 계속과제, 150억원)을 차질없이 추진**

2 연구인력 등 기술 인프라 보강

1 융합공동연구를 통하여 **산업별 특성을 이해하는 창의적 칩설계 인력 양성**(180명, 40억원)

○ ETRI(시스템반도체진흥센터) 주관으로 서울대, 고려대, 한양대, 광운대, 성균관대, KAIST 등에서 **융·복합 공동연구과제 수행**을 통해 추진 (석·박사 100여명, 2011년 24억원)

○ 기존 아날로그 반도체 ITRC*에 추가하여 **멀티미디어 시스템반도체 연구 ITRC를 추가 지정**, 고급 설계인재 양성 추진(정보통신산업진흥원, 석·박사 80여명, 2011년 16억원)

2 MPW 칩제작 기술지원 등 **칩 제작 기술인력 양성 추진**(500명)

○ 대학원생(서울대, 연세대, 고려대, 카이스트 등 국내 67개 대학 참여)을 대상으로 설계툴·칩제작 지원 등을 추진하여 500여명의 칩제작 실무인력 양성(KAIST IDEC 주관, '11년 13억원)

* MPW(Multi Project Wafer) : 1장의 Wafer에 여러개의 설계를 올려서 제작

3 **원천기술개발사업의 인력 양성 기능 강화**를 통해 핵심 설계인력양성 추진

○ 「전자정보디바이스 원천기술개발사업('11년 신규 24억원)」를 활용, 모바일, 모바일, 스마트가전, 자동차, 바이오 등 IT융합분야 시스템반도체 인력양성

- 과제당 10명, 총 20여명의 고급인력 양성 계획

4 **현장 실무 기술인력** 중심으로 재교육 강화(ETRI, 2000여명, '11년 21억원)

5 SoC 설계 및 검증환경 조성, IP공동활용, 신뢰성 시험 등 **기존 인프라 강화**(108억원)

○ ETRI 시스템반도체 진흥센터, 충북TP(Techno Park) 반도체 센터 등에 반도체 설계 CAD Tool, 공동활용 IP, 시제품 개발 지원

* 기술이 미세화됨에 따라 기술개발 비용이 급격히 증가(45나노급 기술개발시 CAD Tool 650억원, 웨이퍼 제작비용 25억원 등 소요)

3 선순환적 생태계 조성 노력 강화

1 대기업 중심의 양질의 자금지원 확대

○ 삼성전자(전체)는 기업은행과 연계, **1조원 규모 상생협력 펀드*** 운영

* 삼성전자와 기업은행이 향후 5년간 각각 2천억원, 8천억원까지 투자할 예정이며, '10.10월부터 지원을 2,3차 협력사로 확대(경영, 연구개발 자금 지원 등에 활용)

- 하이닉스는 상생보증 프로그램을 통해 협력사에 대해 **총 1천억 규모 보증 지원**

○ 삼성(300억원), 하이닉스(150억원) 등 **수요기업이 참여하는 반도체 펀드(1,500억원)를 조성**하여 팹리스 등 **중소 반도체기업 투자재원**으로 활용

* 1차 조성분 600억원에 대한 운용사로 **대신-아주IB, 일신-IBK, JNT인베스트먼트, SV인베스트먼트 등 4개社** 선정 및 협약식 개최 ('10.12)

* 2차 조성(900억원 목표)은 1차분 운용 실적을 보고, '11.7월경 조성 계획

2 파운드리 접근성 개선

○ 삼성전자는 국내 중소 팹리스에게 **첨단 파운드리 접근성** 제고 및 **파운드리 Portfolio 확대**

* 팹리스 업체에게 **MPW서비스**(양산前 시제품 제작) **확대 제공**(65nm, 45nm로 확대 운용추진中)

- **하이닉스는 유휴공정(M8)을 활용, 전략적 팹리스에 파운드리 서비스 제공**

* 현재 3개(실리콘화일, 실리콘웍스, 피델릭스)에서 **'12년까지 5개 이상 확대**

○ **국내 팹리스의** 파운드리 사용 **애로사항을 면밀히 분석**하여 **팹리스 맞춤형 파운드리 개방 MOU 체결 추진 (~'11.4월)**

- 삼성전자, 하이닉스, 동부하이텍 등 3大 Foundry와 중소 Fabless 혹은 정부 사업 참여 기업집단별로 MOU 체결 추진('11년 4월중, 장관 참석)

3 현대자동차, 삼성전자 등 대규모 수요기업과 Fabless와의 선순환적 생태계 조성 노력 강화

○ 자동차용 반도체 등의 **국산화 개발 및 수요기업 구매 촉진**

○ 수요기업, 개발기업, 지경부 **CEO급이 참여하는 간담회 정례화** 추진

* 장·차관, 현대자동차 CEO, 삼성전자 CEO, LG전자CEO 등 모임 추진(반기별 1회)

- 수요·개발 기업 임원급, 지경부 실·국장 등이 참여하는「실무자 Meeting 활성화」(분기별 1회)

○ 수요기업과 반도체 기업이 참여하는「시스템-반도체 포럼」활성화

- 모바일, 스마트 가전, 자동차 등 분과 위원회를 분기별로 개최 하여 업계 애로 발굴 및 발전방향 논의

  * 특히, **수요가 급격히 증가하는 자동차 분야는 1박2일 Workshop 개최(상반기)**

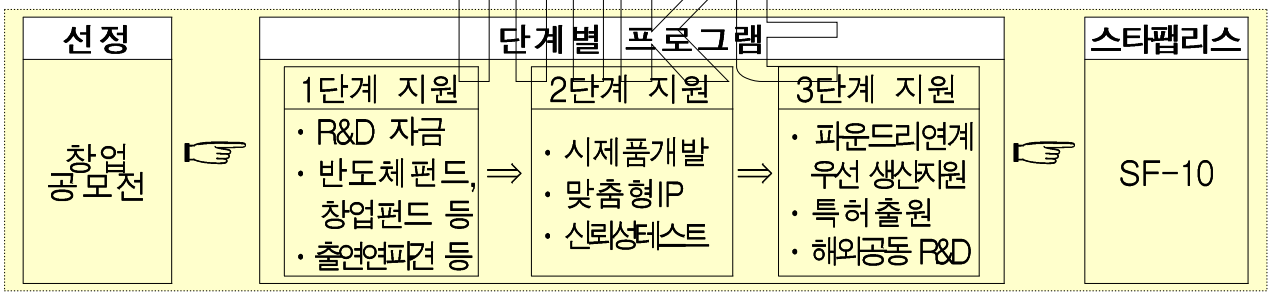
4 중소·중견 시스템반도체 대표기업 육성

○ 잠재력 있는 **창업·초기기업을 대상으로 R&D~판로개척까지 파격적 지원**을 통해 '15년까지 **Star Fabless 10개社(SF-10) 육성**

- **금년중 3~4개사 지원계획**(3월까지 주관기관을 선정하고 창업공모전 등을 통해 **7월까지 SF-10후보 기업 선정**)

  * Star Fabless 例示 : 세계시장 규모가 5억불이상이 되는 품목중에서 세계적 경쟁력을 갖출수 있거나, 세계공인 표준안을 구현하여 시장에 진입할 수 있는 팹리스 기업

< 스타 팹리스 육성 프로그램 예시 >



5 반도체 클러스터 조성

○ 경기 판교의 테크노밸리와 충북 TP를 연결하는 **반도체 클러스터 구축**

- 판교 테크노밸리로 **ETRI 시스템반도체진흥센터, 전자부품연구원 SoC센터 등 지원기관을 이전**하고 **중소기업 지원기능을 대폭 강화***

  * 진흥센터(디지털 특화) 및 전품연(아날로그 특화)내 관련 **장비와 시설을 24시간 개방**하여 편의성을 제고하고, **시험제작 등 상용화 지원 프로그램을 확대**

- 금년 **4월까지 클러스터 구축계획(안)을 마련하고 상반기 중에 확정**

  * 지경부, 경기도, 충북도, 반도체협회, ETRI, KETI로 **클러스터 조성 실무위원회 조성('10.12)** 운영 중

4 SW-시스템반도체 동반육성 전략 수립 (11.6월)

□ 추진배경

○ **주력산업 경쟁력 및 융합의 핵심은 소프트웨어와 시스템반도체**이나, 우리는 대부분 수입에 의존하는 등 열악한 상황 타개

□ 주요내용(안)

○ 미국, 일본 등 선진국과 **대만, 인도 등 신흥 SW-SoC강국사례 집중 분석**

○ SW-SoC 경쟁력 핵심요인 분석

- **SW-SoC 각각의 산업 경쟁력 분석**(자금, 기업성장체계, 인프라, R&D)
- **주력산업-SW-SoC간 융합 경쟁력 분석**(Target 업종 선정 및 로드맵 분석)

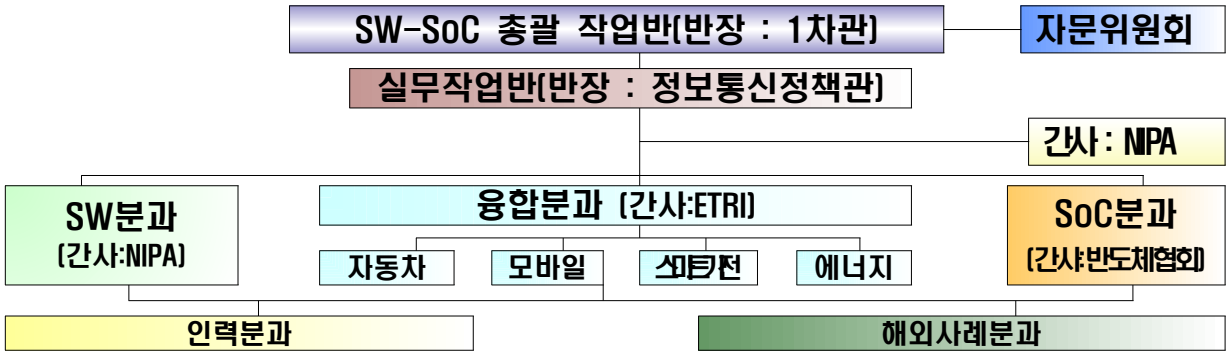
○ **글로벌시장 진입가능성 분석 및 대책**

- 핵심 SW-SoC에 대한 **개발 필요·가능성 분석**을 통해 **'선택&집중' 전략 마련**
  * 例示 : ①글로벌시장Target型, ②니치마켓型, ③수입대체型

○ **인력수급 현황분석 및 대책**

- SW-SoC 기술 수준별 인력수급 현황 및 전망, 인력양성시스템 현황 분석
- 기술 수준별 SW-SoC 핵심 인재양성 방안 마련

□ 추진체계



□ **향후계획** : 「주력산업 고도화를 위한 SoC-SW 동반육성 전략」 수립(11.6)

○ 3월 마지막주에 작업반 모두가 참여하는 SW-SoC 총괄 워크샵을 개최(3.31~4.1)

○ 분과별 보고 4월 21일까지 완성, 실무작업반은 **4월 40일까지 최종 보고서 확정**

* 총괄작업반은 **초안(4.7) 및 최종보고서 완성시점(5.4)**과 **지경부 보고서 초안 완성되는 시점(6월)에** 개최